

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

## 新恒汇电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华金证券 李惠 华金证券 戴笋笋 先锋基金 曾捷 金信基金 刘尚 中恒资本 王慧璞 中恒资本 巩兆飞
时间	2025 年 11 月 18 日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张建东      证券事务代表 宗晓艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张建东先生就公司生产经营情况进行介绍。</p> <p>二、调研的主要问题：</p> <p>1、国内蚀刻引线框架目前主要供应商都有哪些？国产化率大约多少？</p> <p>回复：随着 5G 通信、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的市场需求增长迅速以及国产替代需求的增长，公司的蚀刻引线框架业务也在不断增长。国内蚀刻引线框架目前主要供应商有新恒汇、康强、天水华</p>

洋等厂商，蚀刻引线框架国产化率有待进一步提高。

## **2、蚀刻引线框架产品新上产能的速度快吗？**

回复：公司目前正按照计划实施高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目，持续提高技术工艺研发能力，采用新工艺、开发新产品，丰富产品线，进一步提升产能和产品良率，做好客户的品质保障和产品交付与服务，争取更高市场份额，同时持续加大对潜在客户的资源投入，加快推动新客户的导入及量产工作。

## **3、蚀刻引线框架是不是物联网 eSim 的必要原材料？物联网 Esim 的主要应用场景是在哪里？**

回复：蚀刻引线框架是物联网 eSim 芯片封装的主要原材料。目前，公司在物联网 eSIM 芯片封测领域主要提供 DFN/QFN 封装、MP 卡封装等产品或服务，可适配手机、可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域，具体需根据下游客户需求进行推进。公司会密切关注 eSIM 封测市场需求变化，不断开发新技术、新工艺，积极开拓市场，努力扩大市场份额。

## **4、引线框架属于定制化产品吗？需要与晶圆匹配吗？**

回复：是的，引线框架属于定制化产品，需要与芯片设计厂商的芯片一一对应，属于高度定制化产品。

## **5、公司如何看待未来蚀刻引线和物联网 Esim 的增长路径和增长速度？增量预期可能来自于哪类终端应用？**

回复：未来我国物联网芯片需求将随物联网技术得多领域应用拓展而增长，物联网芯片将向高性能、低功耗、智能化、集成化方向发展，与 5G、AI、边缘计算等技术融合加深，助力物联网设备更智能、高效运行。同时，产业生态逐步完善，芯片设计、制造、封装测试

	等环节协同合作，推动物联网芯片产业快速发展，市场份额和影响力有望进一步扩大。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月18日